

## 双组份导热灌封胶

GF100是一款高效导热有机硅双组份灌封胶，导热系数0.8W/m·K，分为AB组分，按照1:1混合，混合均匀后能自排泡和常温固化，固化后具有防尘、防水防震、阻燃、密封、粘接、导热功能和优异的填缝效果，可用于发热电子元件的导热封装。



### 特性和优点

- 导热系数0.8W/m·K
- 操作时间可调
- 高电气绝缘
- 流动性、浸润性好
- 可实现自动化作业

### 典型应用

- 汽车电子---OBC，DC-DC，连接器，传感器，放大器等
- 工业---LED，电源，功率转换器，变压器，高压电阻器

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色(A/B)	白色/白色	目视
粘度(cps, part A)	10,000	ASTM D2196 5号转子，转速30RPM
粘度(cps, part B)	10,000	
操作时间(25°C,H)	> 6	AB混合后在一起粘度上升到初始值的两倍的时间
固化时间(25°C,H)	< 24	可根据客户调整
密度(g/cc)	1.83	ASTM D792
硬度(Shore A)	55	ASTM D2240
重量损失(%)	≤1.0	滤纸吸附@压缩25% 125°C 48H
耐温范围(°C)	-40~200	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期(月)	3	温度 < 40°C密封储存、避免暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	≥10	ASTM D149
介电常数@1000Hz	5.5	ASTM D150
体积电阻率(Ω.cm)	10 <sup>15</sup>	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/m-K)	0.8	ISO 22007-2